



研究報告

光洋科(1785.TT)

產業：電子-其他電子

AI 材料需求驅動獲利結構升級

投資評價與建議

考量受惠AI資料中心擴建帶動HAMR新硬碟靶材需求成長、高毛利VAS產品比重持續提升，創鉅切入先進製程材料，推升整體獲利結構，雖中長期營運可期，但營運易受到貴金屬價格波動影響，初步基於2026年EPS給予PER 17倍。

重點評論分析

AI儲存需求驅動成長：2Q26及全年，AI訓練與推論帶動資料中心儲存需求提升，推升HDD由PMR升級至HAMR，鉑(Pt)、鈦(Ru)等高價貴金屬用量及精密加工需求同步增加，帶動高毛利VAS收入成長，雖六月營收受金價回落影響，預估月減16.8%至50億元，但2Q26 VAS營收仍季增26.2%至23.1億元，毛利率維持17.45%，稅後EPS 2.72元，下半年受惠金價趨穩及年底備貨旺季，預估2026年VAS營收年增38.9%至89.8億元，毛利率17.35%，稅後EPS 10.17元，另一方面，公司透過子公司創鉅切入2奈米以下先進製程前端靶材，預估2026年前端半導體VAS占比提升至20%，採權益法可挹注母公司EPS約1.26元。

HAMR放量推升獲利：2027年受惠AI資料中心持續擴建，HDD全面導入HAMR新技術，50TB以上大容量硬碟滲透率提升，高價貴金屬用量與精密加工需求增加，帶動高毛利儲存媒體VAS持續成長，另一方面先進製程材料布局，將成為2027年另一獲利成長動能，預估2027年VAS營收年增25%至112億元，毛利率提升至18.79%，稅後EPS達13.68元。

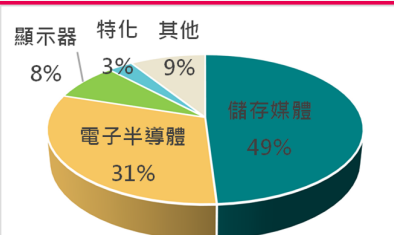
投資風險

國際貴金屬價格波動影響獲利、HAMR導入進度與先進製程材料驗證延後。

增加持股・初次評等

目標價 (NT\$)	170.00
收盤價 (NT\$)	137.00
上漲空間	24.09%

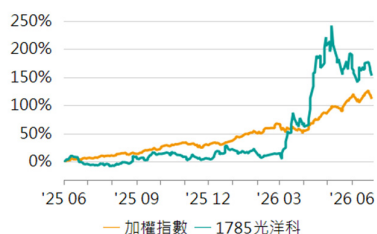
產品營收比重



交易資訊

市值 (NT\$百萬元)	81,649
流通在外股數(百萬股)	596
董監持股 (%)	9.36
外資持股 (%)	13.94
投信持股 (%)	1.06
52 週高價	185.00
52 週低價	49.05
3M 平均成交量(百萬股)	26.68
融資使用率 (%)	28.25

個股與大盤走勢比較圖



資料來源：CMoney・玉山投顧

李悅誠

amaris-72238@esunsec.com.tw

主要財務數據及預估值

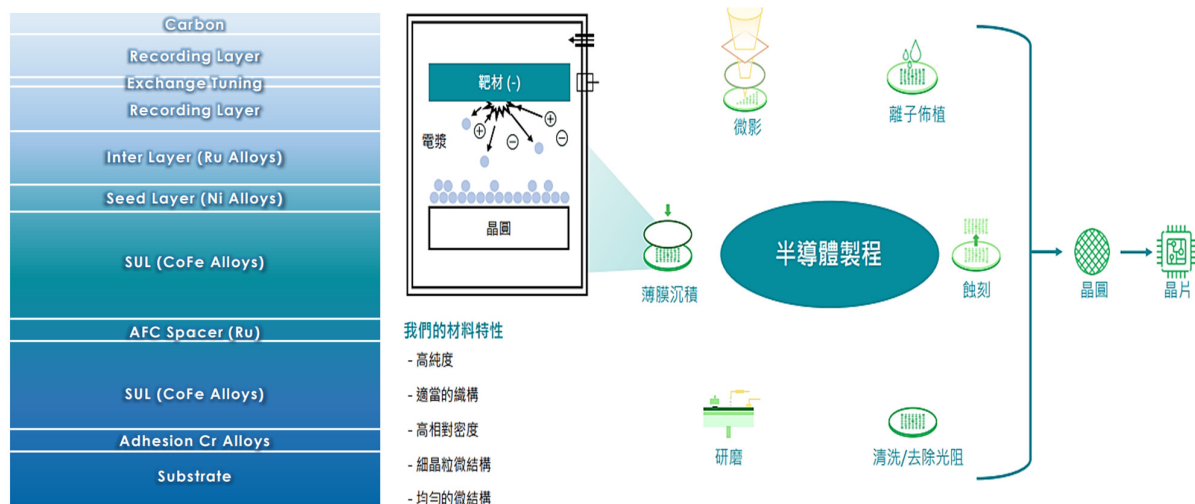
(單位:百萬元)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
營業收入	25,791	22,629	29,770	39,411	63,058	75,039
營業毛利	3,473	2,723	3,812	5,739	10,941	14,103
毛利率(%)	13.47	12.03	12.81	14.56	17.35	18.79
營業利益	1,630	1,366	2,204	4,145	8,358	11,093
營益率(%)	6.32	6.04	7.40	10.52	13.25	14.78
稅前盈餘	1,670	1,289	2,363	2,313	7,897	10,561
稅後EPS(元)	2.35	1.83	3.21	3.14	10.17	13.68
每股股利(元)	1.50	1.20	2.00	2.00	6.48	8.71
營收成長率(%)	-17.75	-12.26	31.56	32.39	60.00	19.00
盈餘成長率(%)	5.88	-22.83	83.37	-2.10	241.35	33.74

公司簡介

光洋科(Solar)成立於 1978 年，總部位於台南，2022 年正式跨足半導體領域，為一家濺鍍薄膜材料、貴金屬、陶瓷材料及汽車化學品之製造、加工、回收、淬鍊及買賣的材料供應商，主要應用於儲存媒體、光電顯示器、電子半導體等產業，公司也將化學配方能力延伸至液冷散熱技術(Coolant)與陶瓷材料(如 YAG、高純氧化鋁)領域，應用於 AI 伺服器及半導體精密設備零組件，在台灣與中國大陸(昆山、江蘇)設有 5 座工廠，核心競爭力在於建立獨特的循環經濟模式，透過回收客戶端的廢料(如廢棄溶液、電子廢棄物)，經由高純度精煉技術，將金、銀、鉑、鈮、鈦、鋼、鎂、等貴稀金屬重新轉化為高純度原料，再製造成高科技材料，如濺鍍靶材、蒸鍍材、粉末及化學品，重新供應給電子產業，這種模式不但確保穩定的原料來源，更在地緣政治下，將這些材料轉化為具備韌性的戰略資源，創造客戶價值，營收主要分為**貴金屬含工帶料收入**與**來料加工收入**(Value Added Sales,VAS)，前者受貴金屬價格波動影響較大，後者則反映公司提供給客戶的產品與服務之真實價值，2025 年 VAS 營收占比儲存媒體 45%、電子半導體 31%、顯示器 8%、特化 3%及其他 9%。

公司在硬碟產業鏈中提供的是磁記錄靶材，主要應用在大數據、AI 伺服器與雲端資料中心儲存的高容量機械硬碟(HDD)內最核心的垂直磁記錄膜層(Perpendicular Magnetic Recording,PMR)，在多個關鍵膜層的靶材，如 PMR/C、IL、SUL 皆為主要供應商，全球市佔率高達 30-35%，是全球前三大硬碟大廠 Seagate 希捷、WD 威騰的核心供應商。

圖表、靶材用於垂直磁記錄膜層(左圖)與半導體薄膜沉積製程(右圖)示意圖



資料來源：玉山投顧、公司資料

公司已於 2025 年 10 月 1 日(分割基準日)將半導體先進製程與封裝事業分割移轉予創鉅先進材料股份有限公司(Xalloy)，並於 2026 年 5 月 11 日正式登錄興櫃買賣(股票代號 7918)，股本 4.31 億元，持有 69.84%股權，創鉅受惠 AI 伺服器與 HPC 強勁需求，帶動前段先進製程、先進封裝及次世代記憶體(MRAM/RRAM)三大領域用的靶材需求快速成長，半導體靶材(Sputtering Target)主要應用在沉積製程 PVD、CVD 技術濺鍍過程所需的原物料，藉由電漿離子的轟擊，將靶材原子打出來、沉積於晶圓上形成薄膜，廣泛應用於半導體製造中金屬層(Interconnect)形成，半導體客戶如台積電、三星、中芯等，公司通過主要晶圓代工廠半導體前段及後段製程驗證的產品，包含

CuP 陽極材、NiPt 靶材、用於互聯層 Cu 合金靶材、用於次世代記憶體 Ru 靶材，並偕同主要晶圓代工廠開發銅合金殘靶的循環經濟，是台灣半導體在地化材料第一供應商，國內先進製程靶材市佔率已達約 90%，提供超高純度半導體材料，並擁有台灣首家半導體銅循環再生靶材的技術。

公司的客戶產業類型包含智慧型手機、電腦、AI 伺服器、顯示器及汽車產業，競爭對手主要為國際材料大廠，如日商 JX Advanced Metals(5016.T)(目前全球市佔率最高，約五成以上)、Tosoh、美商 Solstice Advanced Materials(從 Honeywell 拆分出來)、Praxair(已被德商 Linde 併購)、中國江丰電子及國內鑫科(3663)等，公司憑藉著回收精煉加材料製造的垂直整合模式，在成本控制與碳足跡減少(每年節省約 38.5 萬噸碳排)上具備顯著優勢，2025 年地區營收占比中國 61.4%、台灣 24.6%、其他 14%，目前半導體客戶中台積電約占 70%，其次是三星 7.3%、中芯國際 5.1%、聯華電子 4.4%，封測領域還包含聯電、穩懋、南茂及頤邦，2025 年末有單一客戶收入達公司合併營收 10%以上。

產業趨勢

當前全球正處於 AI 快速增長、地緣政治風險上升及氣候變遷加劇的大趨勢交會點，AI 整體市場中，軟體佔比約 55%，硬體佔比則為 45%，AI 硬體市場規模預計從 2026 年約 1,000 億美元至 2030 年將超過 2,500 億美元，呈現爆發性成長，其中高效能 AI 伺服器將扮演主要成長動能，年成長率預估超過 25%，從 1960-70 年代的集中式運算(Centralized Computing)，演進至 1980-90 年代的資料中心(Data Center)，目前正進入 AI Factory(AI 工廠)階段，其核心產出將從單純的數據存儲轉化為數位詞元(Token)，對基礎設施提出更高要求，需要有三大大技術支柱，算力(Computing Power)、數據(Data)、與熱管理(Thermal Management)，必須同時具備強大的運算力(GPU)、海量的數據儲存及高效的熱能管理，2026 年預計全球伺服器出貨量將成長 19.2%，2028 年預估出貨量將達到約 24,000 千櫃，全球伺服器出貨量之年複合成長率約為 16.2%。

圖表、公司合金靶材相關應用與未來發展

合金材料(靶材)	數據應用	重點發展
銀(Ag)、金(Au)、鉑(Pt)、鈳(Ru)、銅(Cu)、鉭(Ta)、鈦(Ti)	處理：邏輯晶片(CPUs、GPUs)	半導體前段先進節點的超高純合金
鉑(Pt)、鈳(Ru)、鈷(Co)、鐵(Fe)	存儲：存儲系統(HDD、MRAM)	HAMR 及碟片重要記錄層新合金材料
銀(Ag)、金(Au)、銦(In)、鎵(Ga)	介面：電視、手機、AR/VR、折疊式之顯示器	Mini/Micro-LED 的材料
銀(Ag)、金(Au)、鈀(Pd)	傳輸：5G、網路晶片、互連元件、IC 載板	新的合金來優化晶片封裝及連接性

資料來源：玉山投顧、公司資料

隨著先進製程持續微縮，帶動薄膜層數與材料用量增加，2026 年全球晶圓代工產值預計增長 27.8%，其中台灣晶圓代工產值成長率更高達 33.8%，至 2028 年台灣晶圓代工產值將達到約 2,410 億美元，為解決傳統前端供電面臨的供電與訊號互相干擾，以及嚴重電壓與電力耗損問題，開發晶背供電技術(BSPDN)，由於此技術要在背面需製作金屬層、大量的矽通孔(nTSV)及導電層，也使金屬靶材使用量大幅增加，根據 TECHCET 預估，全球半導體靶材市場規模將從 2025 年 14.5 億美元至 2030 年提升至 20.1 億美元，年複合成長率 6.3%，也隨著製程演進，靶材從單一金

屬轉向複合式合金材料，如銅錳(CuMn)、鎢鈦(WTi)、鎳鉑(NiPt)、鈷鐵(CoFe)，帶動靶材產品加工技術與價值提升，2025年創鉅主要營收80-90%來自先進製程金屬互聯層用的銅合金靶材，先進封裝貴金屬散熱層用的黃金靶材佔10-20%，預期2026年先進封裝成長幅度將大於先進製程。

目前產業現況顯示，雖然算力(GPU)是焦點，數據存儲的產量正以驚人速度增長，預計到2028年將達到394 ZB的天文數字，雖然運算晶片的價值占比持續提升，但數據儲存的絕對量依然在同步擴張，在AI時代，全球資料中心存儲需求2024-28年CAGR達20%，隨著存儲需求增加，將帶動傳統硬碟(HDD)與SSD需求成長，在儲存技術路徑上，HDD與SSD呈現互補關係，而非單純的替代，由於HDD在冷資料儲存具備約6倍的成本優勢，且能提供較高的可靠性，目前資料中心內約87%的數據仍由HDD承載，SSD僅佔13%，未來技術動能將受惠於生成式AI引發的海量模型訓練需求及即時推論需求，為應對更高的存儲密度，技術正從傳統的PMR向熱輔助磁記錄(Heat-Assisted Magnetic Recording, HAMR)演進，單一硬碟容量將從目前的30+TB 邁向50+TB，這對靶材的精密度與價值量(VAS)均有顯著挹注，另外熱能管理正成為另一關鍵，公司過去具備液冷配方開發經驗，AI伺服器極高的耗電量帶動散熱技術由氣冷轉向液冷(Liquid Cooling)，未來有機會切入AI server冷卻液市場。

面臨地緣政治帶來的資源戰略化風險，特別是中國對關鍵原物料的出口管制，2023年管制鎵(Ga)、銻(Ge)，2024年管制石墨、銻(Sb)，2025/02管制鎢(W)、鎂(Mg)、銦(In)等多種元素，2025/10新增鎔(Eu)、鉕(Tb)、鐳(Dy)等稀土元素管制，使得自給自足與資源永續成為半導體與伺服器大廠選取供應商的首要考量，公司憑藉自主的回收精煉技術，能從電子廢料中回收金、銀、鉑、鈱、釷、銦、鎵等七種主要關鍵元素，這種穩定的能力使其在資源戰中具備高度防禦性與成長潛力。

圖表、貴金屬與非貴金屬的近一年(截至2026/06/25)國際現貨報價(USD/oz/t oz)



資料來源：Johnson Matthey、KITCO、玉山投顧整理

營運概況

受惠 AI 強勁復甦與獲利結構優化：貴金屬價格容易受市場報價波動影響，1Q26 營收 145.6 億元，含工帶料貴金屬收入佔 87.4%達 127.3 億元，YoY+89.9%，公司主要獲利聚焦在加工營收(VAS)的成長性，VAS 營收佔 1Q26 營收約 12.6%達 18.3 億元，YoY+18.8%，主因來自加工產品組合優化，2025 年儲存媒體 VAS 收入年增 40.4% 占比提升至 45%，1Q26 高毛利的儲存媒體 VAS 營收占比再提升至 49%，毛利/VAS 營收(毛利除以加工營收)比例從 4Q25 的 113.4%再進一步提升至 145.2%，顯示加工獲利仍在持續成長，而其他產品如半導體事業群 1Q26 VAS 營收占比依舊維持在 31%，顯示器 8%、特化(液冷)3%及其他 9%，整體毛利率也從 4Q25 的 16.83%提升

至 18.23%，除了加工營收比重提升以及高毛利加工產品占比提升貢獻外，貴金屬原料庫存於成本項認列跌價損失或回升利益也會影響毛利，營業利益率從 12.0% 提升至 13.9%，稅後 EPS 達 2.54 元。

另外 1Q26 期末存貨金額上升至 212 億元，佔總資產 54%，主要是為了支應 AI 伺服器、大容量硬碟(HAMR)及先進半導體客戶對高階材料的需求，對貴金屬原料如黃金、白金的持續性需求所進行的必要戰略儲備，黃金的佔比相對較高，但在內部的周轉速度也較快，另外 1Q26 業外損益大幅改善，因 2025 年受到貴金屬價格劇烈波動，導致 1Q25 和 2Q25 分別有 4.4 億元和 8.6 億元的業外損失，為了保護庫存不因跌價而貶值，公司通常會建立空頭部位進行避險，當市場金屬價格發生極端暴漲時，實體存貨雖然增值，但對應的空頭避險部位會立即產生會計上的評價損失。

AI 推論帶動儲存需求增長：展望 2Q26 與全年度，公司成長動能將與全球 AI 基礎設施的擴張高度同步，在儲存方面，AI 訓練需大量記憶體與儲存，AI 推論應用亦快速推升即時存取、高速處理海量數據的需求，使 HDD 儲存密度由 PMR 轉向 HAMR 技術，最大的差異在於貴金屬配方的改變，HAMR 製程中，特定貴金屬如鉑(Pt)與鈦(Ru)的使用量與精密配方比例會顯著增加，需要更複雜的薄膜沉積製程，這類精密配方的材料設計門檻較高，因此能直接提升單片技術加工收入，預期這類高價值靶材在全年的滲透率將持續提升，公司獲利聚焦在 VAS 收入與產品組合的演進，國際金價六月有較大幅度下滑，預估六月營收月減 16.8% 至 50 億元，但 2Q26 整體 VAS 營收將季增 26.2% 至 23.1 億元，毛利/VAS 營收仍達 118%，毛利率維持 17.45% 的高水準，稅後 EPS 2.72 元。

下半年隨著國際金價維持穩定的趨勢，材料成本定格低檔、且硬碟產業進入傳統年底備貨旺季，帶動硬碟靶材用量大幅成長，預估 2026 整體 VAS 營收年增 38.9% 至 89.8 億元，毛利/VAS 營收達 121.8%，毛利率提升 2.95ppts 至 17.35%，稅前純益年成長 241.2% 至 79 億元，稅後 EPS 10.17 元。

隨著製程節點演進至 2 奈米及以下(1.6nm/1.4nm)，次世代記憶體(MRAM、RRAM)需要超高純度金屬靶材，對於材料純度與配方精密度的要求極高，已廣泛應用於邏輯 IC 與記憶體的薄膜沉積製程，由於鈦和鉑是先進製程晶片重要材料，原料供應高度集中且產量有限，鈦價格從 2025 年初 500 USD/t oz 上漲至 1500 USD/t oz 以上，在一年間漲幅超過三倍，公司透過拆分子公司創鉅布局先進製程前端靶材，並與台積電 24 小時即時支援，預期在先進技術節點的滲透率逐步擴大，目標前端半導體先進製程的 VAS 營收佔比 2026 年將提升至 20%，創鉅 1Q26 EPS 6.09 元，預估創鉅 2026 年 EPS 可達約 25 元，光洋科擁有近七成創鉅股份，若是以認列長期穩定的投資收益(權益法)，可貢獻母公司 EPS 約 1.26 元。

50TB 以上的超大容量硬碟與先進製程材料帶動 2027 年高毛利加工營收大幅成長：隨 AI 算力推升資料儲存需求與資料中心擴張應用需求爆增，客戶端技術從傳統 PMR 轉向 HAMR，單碟容量邁向 30-50TB 以上，傳統技術已達物理極限，2027 年大廠全面導入 HAMR，由於磁顆粒極小，必須在澱鍍時加入大量的超高價貴金屬與更複雜的特殊結構來維持磁性穩定度，使得靶材加工費顯著增加，加上 HDD 客戶訂單能见度已達 1-2 年，預計 2027 年儲存媒體業務仍持續維持在高營收占比，在 HAMR 靶材的精密配方中，鈦與鉑的使用顯著增加，且先進技術產品的材料設計難度高，雖然料錢增加，但能換取更高的 VAS 貢獻與更好的毛利，透過將客戶端的廢料與殘料純化回高純度原料再重新製成耗材，使其原料自給率達到 70-80%，當國際鈦價上漲時，須購買原物料的競爭對手成本增加，在報價看齊國際行情的含工帶料模式下，會擴大公司整體的獲利空間，加上地緣政治引發資源戰略化的背景下，使其在與先進製程客戶談判時，具備更高的議價權，根據市場預估，AI 時代的硬碟出貨容量，年複合成長率超過 20%，2027 年全球數據產生量預計大幅跨過 100 ZB 朝 2028 年的 394 ZB 邁進，預估 2027 整體 VAS

營收年增 25%至 112 億元，毛利/VAS 營收達 125%，毛利率提升 1.45ppts 至 18.79%，稅前純益年成長 42.4% 至 112.4 億元，稅後 EPS 13.68 元。

因應產業趨勢，未來公司戰略布局將聚焦運算(聚焦先進半導體前端製程材料)、儲存(發展大容量HDD所需的關鍵靶材)、散熱(利用化學配方能力切入AI伺服器液冷市場)、循環經濟(產品進行生命週期結束後的資源回收)，已成功從傳統材料加工逐漸轉型為AI基礎設施關鍵材料供應商。

季度主要財務數據及預估值										
(單位:百萬元)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2025	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	2026
營業收入	8,243	9,525	10,435	11,209	39,411	14,558	16,605	15,082	16,814	63,058
營業毛利	1,219	1,163	1,404	1,886	5,739	2,654	2,898	2,428	2,961	10,941
毛利率(%)	14.79	12.22	13.46	16.83	14.56	18.23	17.45	16.10	17.61	17.35
營業利益	839	1,008	959	1,340	4,145	2,021	2,248	1,778	2,311	8,358
營益率(%)	10.18	10.58	9.19	11.95	10.52	13.88	13.54	11.79	13.74	13.25
稅前盈餘	427	-353	857	1,382	2,313	2,010	2,098	1,628	2,161	7,897
稅後EPS(元)	0.60	-0.50	1.17	1.87	3.14	2.54	2.72	2.11	2.80	10.17
營收成長率(%)	30.57	25.34	36.92	36.08	32.39	76.61	74.34	44.53	50.00	60.00
盈餘成長率(%)	-18.35	盈轉虧	53.02	72.49	-2.10	371.17	虧轉盈	90.00	56.31	241.35

圖 1：營收趨勢 (單位：百萬元，%)

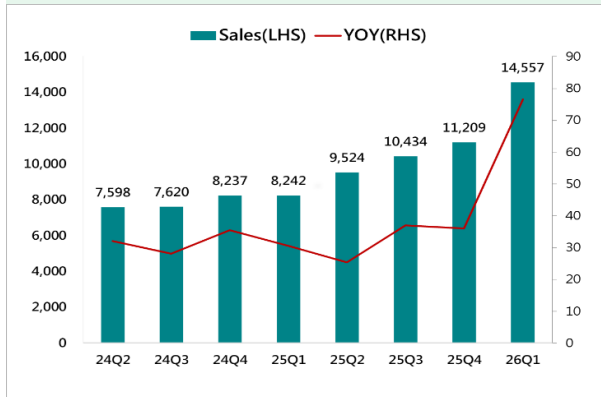


圖 2：毛利率、營益率、淨利率 (單位：百萬元，%)

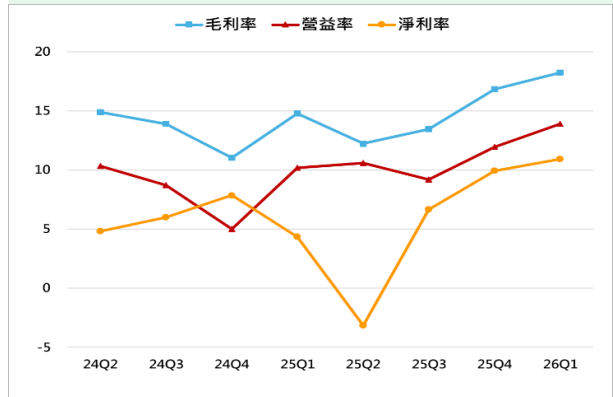


圖 3：經營能力 (單位：天)

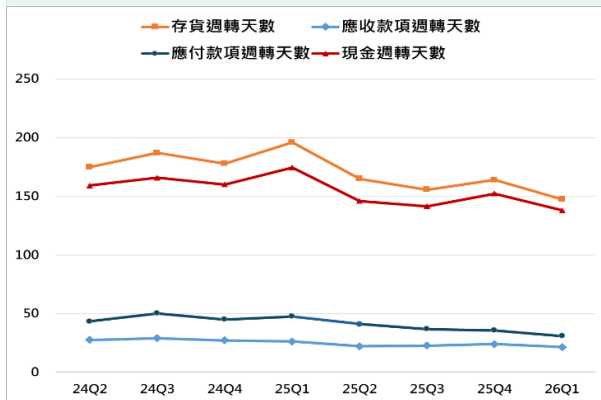


圖 4：自由現金流量 (單位：百萬元)

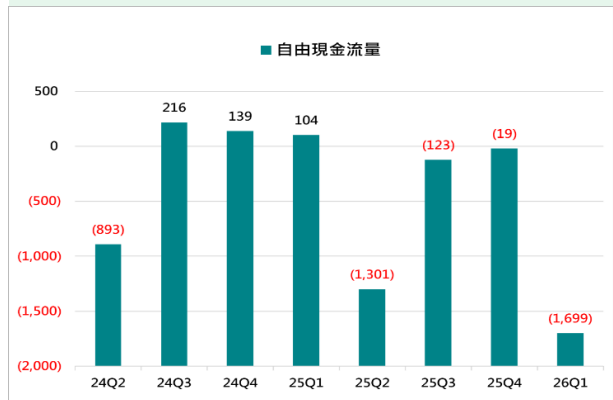


圖 5：本益比區間

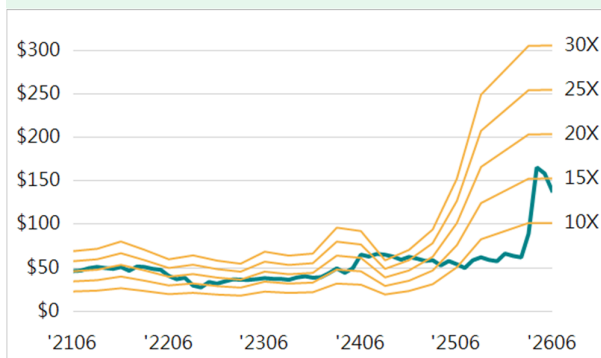
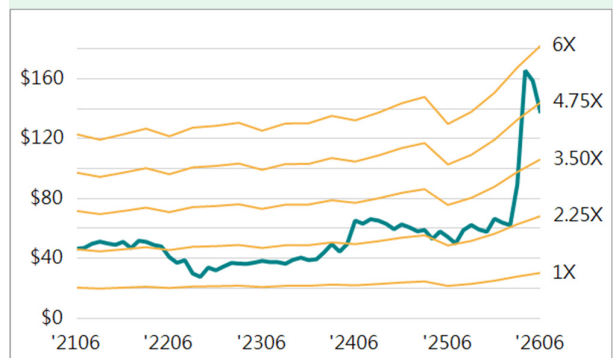


圖 6：股價淨值比



資料來源：CMoney，玉山投顧

年損益表	(單位：百萬元・%)			
	2024	2025	2026(F)	2027(F)
營業收入	29,770	39,411	63,058	75,039
營業成本	25,958	33,673	52,118	60,936
營業毛利	3,812	5,739	10,941	14,103
營業費用	1,608	1,594	2,583	3,010
營業利益	2,204	4,145	8,358	11,093
營業外收支淨額	159	-1,832	-461	-532
稅前淨利	2,363	2,313	7,897	10,561
稅後淨利	1,903	1,867	6,301	8,449
普通股股本	5,962	5,960	5,960	5,960
每股盈餘(元)	3.21	3.14	10.17	13.68
年成長率				
營收	31.56	32.39	60.00	19.00
營業利益	61.37	88.06	101.63	32.73
稅前淨利	83.37	-2.10	241.35	33.74
母公司稅後淨利	75.44	-1.89	237.44	34.08

資產負債表	(單位：百萬元)			
	2022	2023	2024	2025
流動資產	17,077	17,404	22,355	25,670
現金及約當現金	2,206	2,362	1,731	2,624
存貨	11,434	11,566	14,975	17,772
應收帳款及票據	1,729	1,852	2,440	3,069
其他流動資產	1,708	1,624	3,209	2,205
長期投資	419	442	442	432
固定資產	8,091	7,733	7,658	7,576
其他資產	982	880	837	756
資產總額	26,569	26,459	31,292	34,434
流動負債	5,373	6,634	11,532	13,907
應付帳款及票據	0	0	0	0
短期借款	1,445	2,842	4,146	6,633
什項負債	0	0	0	0
非流動負債	7,993	6,867	5,473	5,514
負債總額	13,366	13,501	17,005	19,421
普通股股本	5,971	5,964	5,961	5,960
資本公積	4,148	4,112	4,124	4,130
保留盈餘	2,943	3,119	4,308	4,983
股東權益總額	13,203	12,958	14,287	15,012

現金流量表	(單位：百萬元)			
	2022	2023	2024	2025
稅前淨利	1,669	1,288	2,363	2,313
折舊及攤提費用	494	581	643	665
本期營運資金變動	-893	-720	-2,815	-2,908
其他項目	-260	-67	244	-522
營運活動之現金流量	1,009	1,080	435	-451
資本支出	-1,107	-565	-443	-269
本期長期投資變動	-48	138	0	56
其他項目	271	-618	-1,427	1,083
投資活動之現金流量	-885	-1,045	-1,870	870
短期借款及票券變動	315	1,485	1,486	2,280
舉措/償還長期借款	-1,365	-425	-71	345
發行/償還公司債	777	0	0	-800
現金增資	0	0	0	0
發行現金股利	-890	-895	-715	-1,192
其他項目	55	6	6	40
融資活動之現金流量	-1,108	170	706	674
匯率影響數	41	-50	98	-200
本期現金流量	-941	155	-630	892
期末現金及約當現金	2,206	2,362	1,731	2,624

重要財務比率	(單位：%)			
	2024	2025	2026(f)	2027(F)
毛利率	12.81	14.56	17.35	18.79
營業利益率	7.40	10.52	13.25	14.78
稅前淨利率	7.94	5.87	12.52	14.07
稅後淨利率	6.39	4.74	9.99	11.26
現金股利殖利率	3.68	1.46	4.73	6.36

玉山證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱「玉山投顧」）為玉山金融事業群之成員。

研究報告可自本公司網站(www.esunconsulting.com.tw)取閱。

投資評等說明

買進：未來六個月內潛在漲幅 25%以上。

增加持股：未來六個月內潛在漲幅 10~25%(含)。

中立：未來六個月內漲跌幅-10~10%(含)。

降低持股：未來六個月內潛在跌幅 10%以上。

未評等：無。

研究人員聲明

研究人員聲明無任何其個人報酬來自於本研究報告的建議或觀點。

免責聲明

玉山投顧已針對報告內容力求正確，並為研究人員就其專業能力提供之善意分析，財務預估及投資評等係就報告發行當時，所收集之資訊進行合理之判斷，日後若有資訊更新，玉山投顧將不針對此報告出具更新通知。本報告僅供投資人參考，玉山投顧不負任何投資盈虧之法律責任，如引用本文，須經本公司同意。

智慧財產權聲明

本資料各項內容之各項權利及智慧財產權（包括但不限於著作權、專利權、商標權等）均屬玉山投顧所有。除非獲得玉山投顧事前書面同意外，均不得擅自以任何形式複製、重製、修改、發行、上傳、張貼、傳送、散佈、公開傳播、販售或其他非法使用本資料。除非有明確表示，本資料之提供並無明示或暗示授權 貴方任何著作權、專利權、商標權、商業機密或任何其他智慧財產權。